

ヒートシンク形成用超音波接合機

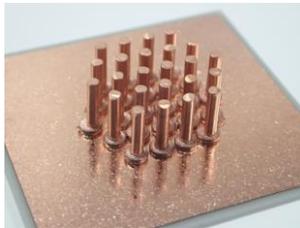


ヘッド荷重	荷重 50~2000N
ヘッド種類	超音波ヘッド
超音波周波数	周波数 : 19kHz(3000W) 、 30kHz(1250W)
ヘッド制御	荷重、超音波のデジタル制御
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシビ	接合条件：デジタル設定
ユーティリティ	空圧源：0.5MPa ドライクリーンエアー
	電源：本体 200V10A 発振器 19kHz 200V20A、30kHz 200V10A
ユニットサイズ	W900 × D900 × H1650mm (本体部)
ユニット重量	800kg

アプリケーション

Cuピン、Alピン、中空ピンに対応

●Cuピン/DBC



●Cuピン/DBA



●Al中空ピン/DBC

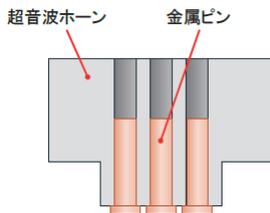


●Al中空ピン/DBA



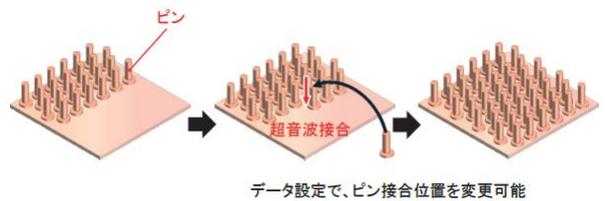
複数ピン一括接合

ピン接合専用ホーンにより、最大4ピンまでの一括接合が可能。4800UPHでヒートシンク形成。



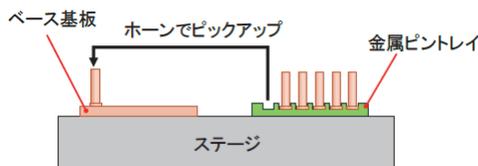
プログラマブルピン形成

データ設定にて、ピン接合位置を自由に変更可。自由度の高いヒートシンク形成が可能。



トレイピン供給

ピンを収納したトレイより金属ピンをピックアップしながら効率的に金属ピンを基板上に接合。



パーツフィーダピン供給 (オプション)

オプションでパーツフィーダの搭載が可能。より効率的なピン供給に対応。

